中美矽晶股份有限公司
綠色債券及國內創新型新創事業投資情形

本公司長期秉持永續經營理念，致力將資金配置於兼具環境與社會效益之投資標的，積極實踐綠色金融與產業創新雙軌並進之策略。謹就永續發展債券投資及國內創新型新創事業投資情形說明如下：其一，由孫公司投資經櫃檯買賣中心認可之綠色債券；其二，由孫公司投資深耕碳化矽材料技術之國內創新型新創事業，攜手推動產業升級與低碳轉型。

永續發展債券投資情形：投資台積電綠色債券，支持綠建築與環境保護

為落實永續金融理念、支持企業低碳轉型，考量投資規模與資金調度效率，本公司透過孫公司兆遠科技股份有限公司於次級市場買進綠色債券，投資金額為新臺幣3,000萬元。

本次投資標的為「台灣積體電路製造股份有限公司 111 年度第 4 期無擔保普通公司債乙類券」（債券簡稱：P11台積4B，代碼：B618D3），債券期間自111年7月27日至116年7月27日，為期5年。該債券業經櫃檯買賣中心認可為綠色債券，募集資金專用於綠建築及綠色環保相關之資本支出。

國內創新型新創事業投資情形：投資碳化矽新創永泉晶圓，強化半導體材料自主

永泉晶圓成立於107年，專注於碳化矽（SiC）單晶晶錠及基板材料的研發與製造，產品應用涵蓋電動車功率元件及高效能運算散熱等領域，是我國第三代半導體關鍵材料供應鏈中具代表性的新創企業。

本公司透過孫公司寰球鑫投資股份有限公司，於114年3月起陸續投資永泉晶圓。截至 115 年第三季止，本公司投資的國內創新型新創事業共 1 家（永泉晶圓，未上市櫃），投資餘額（帳面金額）為新臺幣57,993千元。

永泉晶圓之業務發展與國家產業政策方向一致。依國家發展委員會「六大核心戰略產業推動方案」，行業代號 2611「積體電路製造業」屬於產業之適用對象，而永泉

晶圓之財稅行業別為「磊晶矽晶圓製造」（行業代號 261111），屬於上述 2611「積體電路製造業」範疇。

此外，國家發展委員會「五大信賴產業推動方案」以半導體產業為重點，透過「組成設備及材料國家隊」與「開發新世代半導體技術」兩大策略，推動化合物半導體關鍵材料的發展，碳化矽即為其中的關鍵材料之一。永泉晶圓於 114 年 5 月以「高散熱 SiC 單晶基板材料開發計畫」，獲經濟部產業發展署產業升級創新平台計畫（創新優化類）核定。

本項投資係本公司深化半導體材料策略布局之重要一環。透過資金挹注，本公司協助國內新創企業加速推動碳化矽等第三代半導體關鍵材料之技術研發與產業化，除可強化我國半導體材料供應鏈之自主性與韌性外，亦有助於促進產業技術升級，健全國內半導體創新生態系。

持續以永續為核心　攜手夥伴推動低碳轉型

本公司未來將持續以永續發展為核心，審慎評估並參與具環境與社會效益的投資機會，結合集團在半導體材料領域的專業，與國內新創及產業夥伴攜手推動技術創新與低碳轉型。

附表：投資情形摘要

項目	綠色債券	國內創新型新創事業
投資標的	台積電 111 年度第 4 期無擔保普通公司債乙類券 （P11 台積 4B／B618D3）	永泉晶圓股份有限公司 （統一編號：54942513）
投資單位	兆遠科技股份有限公司 （透過子公司環球晶 100%持股之孫公司）	寰球鑫投資股份有限公司 （透過子公司環球晶 100%持股之孫公司）
首次投資日期	115 年 10 月	114 年 3 月
金額	新臺幣 3,000 萬元	截至 115 年第三季止累積投資餘額新臺幣 57,993 千元（帳面金額）
備註	債券期間 111/7/27～116/7/27；資金用於綠建築及綠色環保相關資本支出	未上市櫃，無收盤價，依帳面金額揭露